



PRESSEMITTEILUNG

Veröffentlichung vom Oktober 2022, Business Unit: Wireless

Wireless

Neue und bewährte Kommunikationslösungen für IoT

Neueste Trends aus den Bereichen 5G und LPWA ebenso wie Dauerbrenner wie Bluetooth und Wi-Fi sind bei HY-LINE auf der Electronica zu sehen. Außerdem erwarten Sie Bluetooth 5 - auch in Kombination mit Wi-Fi - und Produkte mit Wi-Fi 6E in verschiedensten Formfaktoren und Designs.

Die HY-LINE Communication Products zeigt vom 15. bis 18.11.22 in der Wireless-Area auf dem Stand W01 in Halle B5 auf der Electronica neue Kommunikationslösungen für das Internet of Things ihres Partners Multitech, die sich von LoRaWAN bis hin zu Cellular erstrecken; Embedded-Lösungen ebenso wie fertige Router, Gateways und Sensoren.

Die Conduit 300-Serie bietet ein programmierbares Gateway mit LoRa als Ethernet-Backhaul mit optionalen PoE-, 4G-LTE-Mobilfunk- und Wi-Fi-Optionen und einem GNSS-Modul für LoRaWAN-Paket-Zeitstempelung und Geolokalisierung sowie optimierter Edge-to-Cloud Verwaltung.

Der Conduit AP als LoRa-Access Point bietet Ethernet RJ-45 10/100 BaseT für IP-Backhaul, optional auch 4G-LTE und externe Antennen. LoRa Netzwerk-Server und Packet Forwarder sind integriert.

Die MultiConnect eCell ist eine LTE Mobilfunk-zu-Ethernet-Brücke der MTE Serie und unterstützt unter anderem die CBRS-Bänder 48, 42 und 43 für dedizierte und private LTE-Netze, zertifiziert und vom Netzbetreiber zugelassen mit 4G-LTE plus 3G HSPA+ und 2G-Fallback für EU/GB/AU-Netze.

Gutscheine für einen kostenlosen Messebesuch stellt HY-LINE auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

hy-line-group.com/electronica



Pressebild: Multitech Conduit 300 LoRa Gateway



Bild: PM_HY-LINE Communication Products Electronica 2022.jpg

HY-LINE Communication Products

Tel. 089 / 614503-60

Fax 089 / 6140960

Email: communication@hy-line.de